

证券代码：688261

证券简称：东微半导

公告编号：2026-037

苏州东微半导体股份有限公司

关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4040号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16,844,092股，本次发行价格为每股人民币130.00元，募集资金总额为人民币2,189,731,960.00元，扣除保荐承销费155,127,216.60元（不含增值税）后的募集资金为2,034,604,743.40元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年1月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除剩余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用28,048,153.30元后，实际募集资金净额为人民币2,006,556,590.10元。上述募集资金已于2022年1月28日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年1月28日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕42号）。

（二）募集资金累计使用金额和结余情况

公司2026年半年度募集资金使用具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 1 月 28 日

本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	218,973.20
其中：超募资金金额	106,786.56
减：直接支付发行费用	18,317.54
二、募集资金净额	200,655.66
减：	
以前年度已使用金额	179,222.87
本年度使用金额	19,678.16
节余募集资金永久补流金额	6,975.34
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0
其他-具体说明	/
加：	
募集资金利息收入净额	7,578.91
其他-具体说明	/
三、报告期期末募集资金余额	2,358.20

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2022年1月与保荐机构中国国际金融股份有限公司、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022年2月28日，公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的前提下，变更部分募集资金专项账户。公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司于2022年2月28日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、

苏州银行股份有限公司工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

具体内容详见公司于2022年3月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2022-004)。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,公司共有6个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022 年 1 月 28 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州东微半导体股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000318288	0	使用中
苏州东微半导体股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801200006972	0	使用中
苏州东微半导体股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州独墅湖支行	512906076910302	0	使用中
苏州东微半导体股份有限公司	交通银行股份有限公司苏州科技支	325060700013000751708	0	使用中

司	行			
苏州东微 半导体股 份有限公 司	苏州银行股 份有限公司 工业园区支 行	51549300001103	2,358.20	使用中
苏州东微 半导体股 份有限公 司	中信银行股 份有限公司 苏州工业园 区支行	8112001011868888888	0	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金投资项目资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年2月12日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议及第二届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币21,900万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年2月13日在上海证券交易所网站披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-001）。

截至2026年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理均已到

期赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2026年4月24日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营。公司超募资金总额为106,786.56万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额不超过19,700.00万元，占超募资金总额的比例为18.45%。公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%，并在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）。

截至2026年6月30日，公司累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额为109,678.16万元。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资

金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022 年 1 月 28 日										
本年度投入募集资金总额			19,678.16										
已累计投入募集资金总额			198,901.03										
变更用途的募集资金总额			不适用										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

													重大变化
超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目	研发项目	否	20,414.58	20,414.58	20,414.58		20,639.92	225.34	101.10	2023年8月	不适用	不适用	否
新结构功率器件研发及产业化项目	研发项目	否	10,770.32	10,770.32	10,770.32		10,105.71	-664.61	93.83	2024年7月	不适用	不适用	否
研发工程中心建设项目	研发项目	否	16,984.20	16,984.20	16,984.20		11,982.18	-5,002.03	70.55	2025年8月	不适用	不适用	否
科技与发展储备资金	其他	否	45,700.00	45,700.00	45,700.00		43,893.20	-1,806.80	96.05	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-		93,869.10	93,869.10	93,869.10		86,621.01	-7,248.09	92.28	—	-	-	-
超募资金投向													
永久补充流动资		否	-	104,184.70	104,184.70	19,678.16	109,678.16	5,493.46	105.27	不适用	不适	不适	否

[illegible]

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：“回购股份”行所有数据均包含手续费佣金及证券回购账户的利息收入。